proMa Technologie GmbH **02.09.02**

FR4 nach IEC			
249 -2-5			
Techn. Daten	**Leiterplatten- Basismaterial**		
proMa- Artikel-Nr.	10150 0200		
Conrad- Artikel-Nr.	**528579**		
A) mech. Daten :			
Plattenstärke :		1,00 mm	+/-0,14mm
Cu-Schicht	99,8 % Cu	2x35my	
Abmessungen: siehe Katalog			
B) Fotopositiv beschichtes			
Material			
mit mit Lichtschutzfolie			
C:Basismaterial	Glasfilamentgewebe mit Epoxyd		
D: sonst. Daten	Grundlagen	Einheiten	Wert
Oberflächenwiderstand	C-96/20/65	Ohm	5x10°14
Dielektrizitätszahlb. 1Mhz	C-96/20/65+D-48/50		kleiner 5,5
spez. Durchg. Widerstand	C-96/20/65	Ohm/cm	5x10(14)
Dielektrischer Verlustfaktor	c96/20/65		kleiner 0,03
Dielektrischer Verlustfaktor	C96/20/65+D-48/50		kleiner 0,035
Flammfestigkeit			UL94V0
Arbeitstemperatur		°C	130
Lötzeit bei	260 °C	sec	größer 40
Haftvermögen der Cu -Folie		Kg/cm	1,5
Biegefestigkeit Längs		N/qmm	400
Biegefestigkeit quer		N/qmm	350
Grenztemperatur	nach 30 min -keine Blasenbildung	°C	190